

# 2022-2028年中国COF行业市场竞争力分析及发展 策略分析报告

报告大纲

智研咨询

[www.chyxx.com](http://www.chyxx.com)

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国COF行业市场竞争力分析及发展策略分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202103/937249.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 400-700-9383、010-60343812、010-60343813

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

COF ( Chip On Flex , or , Chip On Film ) , 常称覆晶薄膜, 是将集成电路 ( IC ) 固定在柔性线路板上的晶粒软膜构装技术, 运用软质附加电路板作为封装芯片载体将芯片与软性基板电路结合, 或者单指未封装芯片的软质附加电路板, 包括卷带式封装生产 ( TAB基板, 其制程称为TCP )、软板连接芯片组件、软质IC载板封装。

智研咨询发布的《2022-2028年中国COF行业市场竞争力分析及发展策略分析报告》共八章。首先介绍了COF行业市场发展环境、COF整体运行态势等, 接着分析了COF行业市场运行的现状, 然后介绍了COF市场竞争格局。随后, 报告对COF做了重点企业经营状况分析, 最后分析了COF行业发展趋势与投资预测。您若想对COF产业有个系统的了解或者想投资COF行业, 本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据, 海关总署, 问卷调查数据, 商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局, 部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据, 企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等, 价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 COF产品概述

第一节 COF的定义

第二节 COF品种

第三节 COF——目前的主流挠性IC封装形式

一、IC封装

二、IC封装基板与常规印制电路板在性能、功能上的差异

三、IC封装基板的种类

第四节 COF与TAB、TCP、TAPE BGA/CSP在定义上的区别

第五节 COF在驱动IC中的应用

第六节 COF行业与市场发展概述

第二章 COF的结构及其特性

第一节 COF的结构特点

第二节 COF在LCD驱动IC应用中的特性

第三节 COF与其它IC驱动IC封装形式的应用特性对比

第四节 未来COF在结构及其特性上的发展前景

第五节 COF的更高阶封装形式——基于挠性基板的3D封装的发展

第三章 驱动IC产业现状与发展

第一节 驱动IC的功能与结构

- 一、驱动IC的功能及与COF的关系
  - 1、驱动IC的功能
  - 2、驱动IC与COF的关系
- 二、驱动IC的结构
- 三、驱动IC的品种
- 第二节 驱动IC在发展LCD中具有重要的地位
- 第三节 大尺寸TFT-LCD驱动及其特点
  - 一、大尺寸TFT-LCD驱动特点
  - 二、大尺寸TFT-LCD驱动芯片设计难点
- 第四节 驱动IC产业的特点
- 第五节 世界显示驱动IC的市场现况
  - 一、显示驱动IC制造厂商与下游LCD面板厂家的关系及分析
  - 二、世界显示驱动IC设计业现况
  - 三、世界显示驱动IC市场规模调查统计
- 第六节 世界显示驱动IC主要生产厂家的现况
- 第四章 液晶面板应用市场现状与发展
  - 第一节 世界液晶面板市场规模与生产情况概述
  - 第二节 世界大尺寸TFT-LCD应用市场发展现况
  - 第三节 我国液晶面板市场规模与生产情况概述
- 第五章 COF的生产工艺及技术的发展
  - 第一节 COF制造技术总述
    - 一、COF的问世
    - 二、COF的技术构成
  - 第二节 COF挠性基板的生产工艺技术
    - 一、COF挠性基板生产的工艺过程总述及工艺特点
    - 二、挠性基板材料的选择
    - 三、精细线路的制作
  - 第三节 IC芯片的安装技术
  - 第四节 COF挠性基板的主要性能指标
- 第六章 世界COF基板的生产现状
  - 第一节 全世界COF基板生产量统计
  - 第二节 全世界COF市场格局
  - 第三节 全世界COF基板主要生产厂家的
  - 第四节 全世界COF基板主要生产情况
- 第七章 我国COF基板的生产现状

## 第一节 我国FPC业的现状

### 第二节 我国COF的生产现状

### 第三节 我国COF基板的生产企业现状

#### 三、三德冠精密电路科技有限公司

#### 四、上达电子（深圳）股份有限公司

#### 五、厦门弘信电子科技股份有限公司

## 第八章 COF挠性基板用二层型挠性覆铜板特性与生产现状

### 第一节 二层型挠性覆铜板品种及特性

### 第二节 挠性覆铜板产品主要采用的标准及性能要求

#### 一、适用于FCCL的中国国家标准介绍

#### 二、国际上广泛使用的FCCL标准介绍

##### 1、IPC标准

##### 2、IEC标准

##### 3、日本标准

##### 4、测试方法比较

#### 三、实际产品应用中的性能要求

### 第三节 挠性覆铜板的生产工艺

#### 一、三层型挠性覆铜板的生产工艺

##### 1、片状制造法

##### 2、卷状制造法

#### 二、二层型挠性覆铜板的生产工艺

##### 1、涂布法（CASTING）

##### 2、层压法（LAMINATION）

##### 3、溅镀法（SPUTTERING/PLATING）

### 第四节 世界挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

#### 一、总述

#### 二、日本FCCL业生产现状与发展

#### 三、美国、欧洲FCCL业的现状与发展

#### 四、台湾FCCL业的现状与发展

#### 五、韩国FCCL业的现状与发展

### 第五节 我国国内挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

#### 一、我国国内挠性覆铜板业发展总述

#### 二、我国国内挠性覆铜板生产厂家现况（ZYZS）

#### 图表目录：

#### 图表 1：三种封装基板的CTE及对CCL的CTE要求

图表 2：COF与COG比较分析

图表 3：COF与TAB比较分析

图表 4：2017-2021年世界显示驱动IC市场规模调查统计

图表 5：世界显示驱动IC主要生产厂家分析

图表 6：2017-2021年全球主流面板厂商分区域销售额走势（单位：十亿美元）

图表 7：2017-2021年全球大尺寸面板出货数量及同比走势（单位：百万台，%）

图表 8：2017-2021年全球大尺寸面板分应用平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 9：2022-2028年全球液晶电视面板平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 10：2022-2028年全球液晶电视面板分分辨率占比走势（%）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202103/937249.html>